

# 有価証券報告書

(金融商品取引法第24条第1項に基づく報告書)

事業年度 自 平成23年4月1日  
(第7期) 至 平成24年3月31日

## 株式会社テラプローブ

神奈川県横浜市港北区新横浜二丁目7番17号

(E24994)

# 目次

頁

表紙

第一部 企業情報	1
第1 企業の概況	1
1. 主要な経営指標等の推移	1
2. 沿革	3
3. 事業の内容	4
4. 関係会社の状況	7
5. 従業員の状況	8
第2 事業の状況	9
1. 業績等の概要	9
2. 生産、受注及び販売の状況	11
3. 対処すべき課題	12
4. 事業等のリスク	13
5. 経営上の重要な契約等	19
6. 研究開発活動	20
7. 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析	21
第3 設備の状況	25
1. 設備投資等の概要	25
2. 主要な設備の状況	25
3. 設備の新設、除却等の計画	26
第4 提出会社の状況	27
1. 株式等の状況	27
2. 自己株式の取得等の状況	37
3. 配当政策	37
4. 株価の推移	37
5. 役員の状況	38
6. コーポレート・ガバナンスの状況等	42
第5 経理の状況	47
1. 連結財務諸表等	48
(1) 連結財務諸表	48
(2) その他	80
2. 財務諸表等	81
(1) 財務諸表	81
(2) 主な資産及び負債の内容	98
(3) その他	101
第6 提出会社の株式事務の概要	102
第7 提出会社の参考情報	103
1. 提出会社の親会社等の情報	103
2. その他の参考情報	103
第二部 提出会社の保証会社等の情報	104

[監査報告書]

## 【表紙】

【提出書類】	有価証券報告書
【根拠条文】	金融商品取引法第24条第1項
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成24年6月26日
【事業年度】	第7期（自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日）
【会社名】	株式会社テラプローブ
【英訳名】	Tera Probe, Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 渡辺 雄一郎
【本店の所在の場所】	神奈川県横浜市港北区新横浜二丁目7番17号
【電話番号】	045（476）5711
【事務連絡者氏名】	執行役員 CFO 神戸 一仁
【最寄りの連絡場所】	神奈川県横浜市港北区新横浜二丁目7番17号
【電話番号】	045（476）5711
【事務連絡者氏名】	執行役員 CFO 神戸 一仁
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町2番1号）

## 第一部【企業情報】

### 第1【企業の概況】

#### 1【主要な経営指標等の推移】

##### (1) 連結経営指標等

回次	第3期	第4期	第5期	第6期	第7期
決算年月	平成20年3月	平成21年3月	平成22年3月	平成23年3月	平成24年3月
売上高 (千円)	—	18,624,790	17,836,950	21,381,338	24,190,114
経常利益又は 経常損失 (△) (千円)	—	△4,232,948	2,585,384	4,835,290	2,402,003
当期純利益又は 当期純損失 (△) (千円)	—	△5,903,792	2,231,284	4,151,465	△5,529,977
包括利益 (千円)	—	—	—	4,449,979	△5,359,354
純資産額 (千円)	—	15,169,253	17,661,055	26,557,660	21,198,305
総資産額 (千円)	—	36,942,508	32,739,840	50,325,335	41,088,795
1株当たり純資産額 (円)	—	18,338.04	21,278.86	2,681.80	2,084.25
1株当たり当期純利益金額 又は1株当たり当期純損失 金額 (△) (円)	—	△7,687.23	2,905.32	509.44	△595.74
潜在株式調整後 1株当たり当期純利益金額 (円)	—	—	—	—	—
自己資本比率 (%)	—	38.1	49.9	49.5	47.1
自己資本利益率 (%)	—	—	14.7	20.1	—
株価収益率 (倍)	—	—	—	4.60	—
営業活動による キャッシュ・フロー (千円)	—	8,796,061	9,327,151	10,382,013	9,813,515
投資活動による キャッシュ・フロー (千円)	—	△4,628,545	△807,796	△8,503,314	△10,671,740
財務活動による キャッシュ・フロー (千円)	—	△8,212,785	△7,469,502	2,532,815	△804,376
現金及び現金同等物の 期末残高 (千円)	—	1,761,676	2,820,690	7,211,189	5,557,662
従業員数 (外、平均臨時雇用者数) (人)	—	301 (338)	311 (170)	390 (80)	660 (160)

(注) 1. 売上高には消費税等は含まれておりません。

2. 当社は第4期より連結財務諸表を作成しております。

3. 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載しておりません。

4. 自己資本利益率については、当期純損失の場合は記載しておりません。

5. 株価収益率については、当社株式は第5期までは非上場であるため、記載しておりません。また、第7期は、当期純損失であるため記載しておりません。

6. 第4期以降の連結財務諸表については、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、新日本有限責任監査法人の監査を受けております。

7. 第4期は、米国のサブプライムローン問題を背景とした金融市場の混乱などにより消費が大きく落ち込み、当社のテスト受託にも大きな影響が生じた結果、売上高、損益とも大きく落ち込みました。

8. 第5期より固定資産の耐用年数を変更したことにより経常利益、当期純利益等の金額に影響が出ており、変更前の方法によった場合に比べて、同期の経常利益及び税金等調整前当期純利益は、それぞれ3,553,055千円、3,455,219千円増加しております。

9. 第7期は、特別損失として貸倒引当金繰入額及び減損損失等を計上した結果、当期純損失となりました。

10. 当社は、平成22年5月28日付で株式1株につき10株の株式分割を行っております。

## (2) 提出会社の経営指標等

回次		第3期	第4期	第5期	第6期	第7期
決算年月		平成20年3月	平成21年3月	平成22年3月	平成23年3月	平成24年3月
売上高	(千円)	23,059,500	17,900,293	15,835,180	18,144,772	19,080,956
経常利益又は 経常損失(△)	(千円)	1,413,732	△4,404,803	2,082,836	3,874,890	2,297,153
当期純利益又は 当期純損失(△)	(千円)	703,227	△5,966,035	2,063,524	3,801,136	△6,091,080
資本金	(千円)	9,600,000	9,600,000	9,600,000	11,823,312	11,823,312
発行済 株式総数	普通株式(株)	260,000	740,000	768,000	9,282,500	9,282,500
	A種類株式(株)	508,000	508,000	—	—	—
純資産額	(千円)	20,250,116	14,284,080	16,347,605	24,595,366	18,504,285
総資産額	(千円)	53,823,523	35,962,438	30,970,566	45,399,955	33,395,094
1株当たり純資産額	(円)	26,367.34	18,599.06	21,285.94	2,649.65	1,993.46
1株当たり配当額 (うち1株当たり中間配当額)	(円)	— (—)	— (—)	— (—)	— (—)	— (—)
1株当たり当期純利益金額 又は1株当たり当期純損失 金額(△)	(円)	915.66	△7,768.28	2,686.88	466.45	△656.19
潜在株式調整後 1株当たり当期純利益金額	(円)	—	—	—	—	—
自己資本比率	(%)	37.6	39.7	52.8	54.2	55.4
自己資本利益率	(%)	3.5	—	13.5	18.6	—
株価収益率	(倍)	—	—	—	5.03	—
配当性向	(%)	—	—	—	—	—
従業員数 (外、平均臨時雇用者数)	(人)	235(373)	253(338)	227(170)	283(80)	294(123)

- (注) 1. 売上高には消費税等は含まれておりません。
2. 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載しておりません。
3. 自己資本利益率については、当期純損失の場合は記載しておりません。
4. 株価収益率については、当社株式は第5期までは非上場であるため、記載しておりません。また、第7期は、当期純損失であるため記載しておりません。
5. A種類株式は無議決権株式であり、交付請求に応じてA種類株式との引換えにより交付される普通株式の数は、取得されるA種類株式の数に、A種類株式1株の払込金相当額50,000円(A種類株式につき株式分割、株式併合その他一定の事由が生じた場合はそれぞれにつき適宜調整されます。)をその時点における交換価額(払込金相当額。ただし、当該価額より低い発行価額による当社普通株式の新株発行その他一定の事由により下方調整されます。)で除した数を乗じて算出されます。なお、当社は平成17年9月29日付の第三者割当増資により94,000株、平成19年3月31日付で吸収分割に伴い160,000株のA種類株式を発行していましたが、平成22年3月31日付で全数(平成20年2月15日付株式分割により508,000株)消却しております。
6. 第4期は、米国のサブプライムローン問題を背景とした金融市場の混乱などにより消費が大きく落ち込み、当社のテスト受託にも大きな影響が生じた結果、売上高、損益とも大きく落ち込みました。
7. 第5期より固定資産の耐用年数を変更したことにより経常利益、当期純利益等の金額に影響が出ており、変更前の方法によった場合に比べて、同期の経常利益及び税引前当期純利益は、それぞれ3,553,055千円、3,455,219千円増加しております。
8. 第7期は、特別損失として貸倒引当金繰入額及び減損損失等を計上した結果、当期純損失となりました。
9. 第3期及び第4期の1株当たり当期純利益金額又は1株当たり当期純損失金額はA種類株式の期中平均株式数を含めた、768,000株として計算しております。
10. 第4期から第5期にかけて従業員数が減少しているのは、他社への一時的な出向者を差し引いているためです。
11. 第4期以降の財務諸表については、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、新日本有限責任監査法人の監査を受けております。
12. 当社は、平成20年2月15日付で株式1株につき2株の株式分割を、また、平成22年5月28日付で株式1株につき10株の株式分割を行っております。

## 2 【沿革】

年月	事項
平成17年8月	東京都中央区に当社設立。資本金1,000万円。
平成17年9月	エルピーダメモリ株式会社、Kingston Technology Japan, LLC、Powertech Technology Inc. 及び株式会社アドバンテストを割当先とする第三者割当増資を実施。新資本金56億円。 産業活力再生特別措置法(注1)に基づく「経営資源再活用計画」の認定取得。
平成17年10月	広島事業所（広島県東広島市）にてDRAM(注2)のウエハテスト事業(現メモリ事業)(注3)を開始。 開発センター（神奈川県相模原市中央区）にてテスト技術等の開発受託事業(現メモリ事業)を開始。
平成18年5月	広島事業所にてエルピーダメモリ株式会社以外のウエハテスト事業(現メモリ事業)を開始。
平成18年6月	広島事業所にてISO9001（品質マネジメントシステム）の認証取得。 熊本県葦北郡芦北町に九州事業所用地及び建物取得。
平成18年9月	九州事業所を開設。ロジック製品のファイナルテスト事業(現システムLSI事業)(注3)を開始。
平成18年11月	九州事業所にてロジック製品のウエハテスト事業(現システムLSI事業)を開始。
平成19年1月	九州事業所にてISO9001（品質マネジメントシステム）の認証取得。
平成19年3月	神奈川県横浜市港北区に本社・開発センターを移転。 産業活力再生特別措置法の上記認定の取消し(注4)、及び同法に基づく「事業再構築計画」の認定取得。 吸収分割により広島エルピーダメモリ株式会社（現：エルピーダメモリ株式会社）からウエハテスト事業(現メモリ事業)に関する設備・装置等を承継。新資本金96億円。
平成19年4月	DRAM以外の半導体受託拡大を目指し、九州事業所にB棟竣工。
平成19年9月	九州事業所B棟操業開始。
平成19年12月	ISO14001（環境マネジメントシステム）の認証取得。 ISO27001（情報セキュリティマネジメントシステム）の認証取得。
平成20年8月	台湾新竹縣に台湾における事業拡大を目的として、Powertech Technology Inc. と合併で連結子会社 TeraPower Technology Inc. を設立。
平成21年3月	エルピーダメモリ株式会社の連結子会社となる。
平成21年7月	九州事業所内にデバイス開発・評価サービスを提供する目的でテストセンターを開設。
平成22年2月	事業部制を導入。メモリ事業部、システムLSI事業部を設置。
平成22年12月	東京証券取引所マザーズに株式を上場。 エルピーダメモリ株式会社の持株比率低下により持分法適用会社となる。
平成23年10月	カシオ計算機株式会社より株式会社テラミクロスの全株式を取得、連結子会社として、ウエハレベルパッケージ(WLP)の受託を開始。

(注) 1. 産業活力再生特別措置法：日本における経営資源の効率的な活用を通じて生産性の向上を実現するため、特別の措置として、事業者が実施する事業再構築、共同事業再編及び経営資源再活用を円滑化するための措置を雇用の安定等に配慮しつつ講じるとともに中小企業の活力の再生を支援するための措置を講じ、併せて事業者の経営資源の増大に資する研究活動の活性化等を図ることにより、日本産業の活力の再生を速やかに実現することを目的として平成11年に制定された法律です。

2. 「3 事業の内容 用語解説」をご参照ください。

3. 「3 事業の内容」をご参照ください。

4. 広島エルピーダメモリ株式会社からのウエハテスト承継の形態を、当初計画の営業譲渡から、吸収分割に変更したことに合わせた形で改めて認定を取得するため、平成17年9月に取得した認定の取り消しを受ける手続をとったものです。

### 3【事業の内容】

当社グループは、当社（株式会社テラプローブ）、国内連結子会社（株式会社テラミクロス、以下「テラミクロス」といいます。）及び海外連結子会社（TeraPower Technology Inc. 以下、「テラパワー」といいます。）により構成されており、半導体製造工程におけるウエハテスト及びファイナルテスト受託とウエハレベルパッケージ（以下、「WLP」といいます。）受託を主たる業務としております。

一般的に半導体製造工程は、ウエハ(\*1)上に半導体チップを作り込む前工程(\*2)と、半導体チップを組立しパッケージングする後工程(\*3)に分類されます。この前工程で行う検査をウエハテストといい、後工程で行う検査をファイナルテストといいます。当社グループでは、どちらのテスト工程も受託しております。

ウエハテストとは、ダイシング(\*4)前のウエハ状態で、ウエハ上に作り込まれた半導体チップの電気特性を検査し、良品・不良品の判別を行うものです。具体的には、回路が作り込まれたウエハ上の半導体チップにあるパッド(\*5)の一つ一つに、プローブと呼ばれる細い探針を当てて電気信号を流し、半導体回路が設計どおりに機能しているかをテスト(\*6)、プローバ(\*7)等の装置を用いて電氣的に検査します。

さらに当社は、当社の蓄積したノウハウを利用したプログラムの改良を提案し、顧客から支給されたテストプログラムを基に多数個同時測定用プログラムを開発したり、プローブカード(\*8)設計を受託することなどによって、一回のテストでより多くの半導体チップを検査できるようにし、テスト効率を上げることで、顧客のウエハテストのコスト低減に貢献しております。

また、ファイナルテストとは、組立終了後のパッケージ状態で設計どおりに機能するかどうかの検査のほか、最終製品の外観異常の有無を検査するパッケージ外観検査などを含みます。

WLPは、半導体パッケージングの中でもパッケージング後のサイズが小さく、薄いことが特徴のパッケージで、ウエハ状態で加工することで、多数のチップを一括して加工できるという特徴があります。この特長を生かして、スマートフォンなどのモバイル機器で多く採用されています。

当社グループの事業内容及び当社と関係会社の当該事業に係る位置付けは次のとおりであります。

#### (1) メモリ事業

当社グループのメモリ事業の主な業務はDRAM(\*9)のウエハテスト業務の受託であり、主に広島事業所とテラパワーで行っております。当社グループは、当社を持分法関係会社とするエルピーダメモリ株式会社のような日本国内の半導体メーカーや、海外の半導体メーカー、ファブレス等からウエハテストを受託しております。

一般的にウエハテストは、上記のように顧客から支給されたテストプログラムを使用し、ウエハ上に作り込まれた半導体チップの電気特性をテストし、良品・不良品の判別を行い、その結果を顧客に提供して業務が完了します。これに対し、メモリ事業の売上の多くを占めるDRAMでは、ウエハ1枚からより多くの半導体チップを製品化できるように、半導体チップにレーザーを用いた加工を施し、顧客の製造した半導体チップの歩留確保、向上を行っております。

また、マルチチップパッケージ(MCP(\*10))など複数の異なるチップを封入する半導体デバイスでは、1個のチップに不具合があると他の正常なチップまで廃棄せざるを得ず、全体の歩留低下とコストアップの問題を発生させてしまいます。当社グループでは、このような顧客のコストアップを回避するために、あらかじめ半導体に高温、高電圧をかけることで、不良となるおそれのある製品を選別するバーンインテストをウエハ状態でを行い、製造工程における不具合品を選別します。当社グループでは、この技術(ウエハレベルバーンイン(\*11)技術)を確立し、製品の信頼性を高めております。

今後、高機能化が進み、コスト面からも更なる微細化の進展が予想され、また半導体製品の用途が自動車などの信頼性が重視される分野に広がることで、これらの歩留向上や品質、信頼性の確保に有用な技術はますます重要な差別化ポイントとなってくるものと考えております。

また、当社グループは、半導体受託生産が盛んな台湾で、連結子会社のテラパワーが事業を行っており、同市場において国内と同じ品質でメモリ製品のウエハテスト業務を提供し、テストコスト低減に貢献することで、国内顧客の生産が海外へ移っても受注機会を確保してまいります。

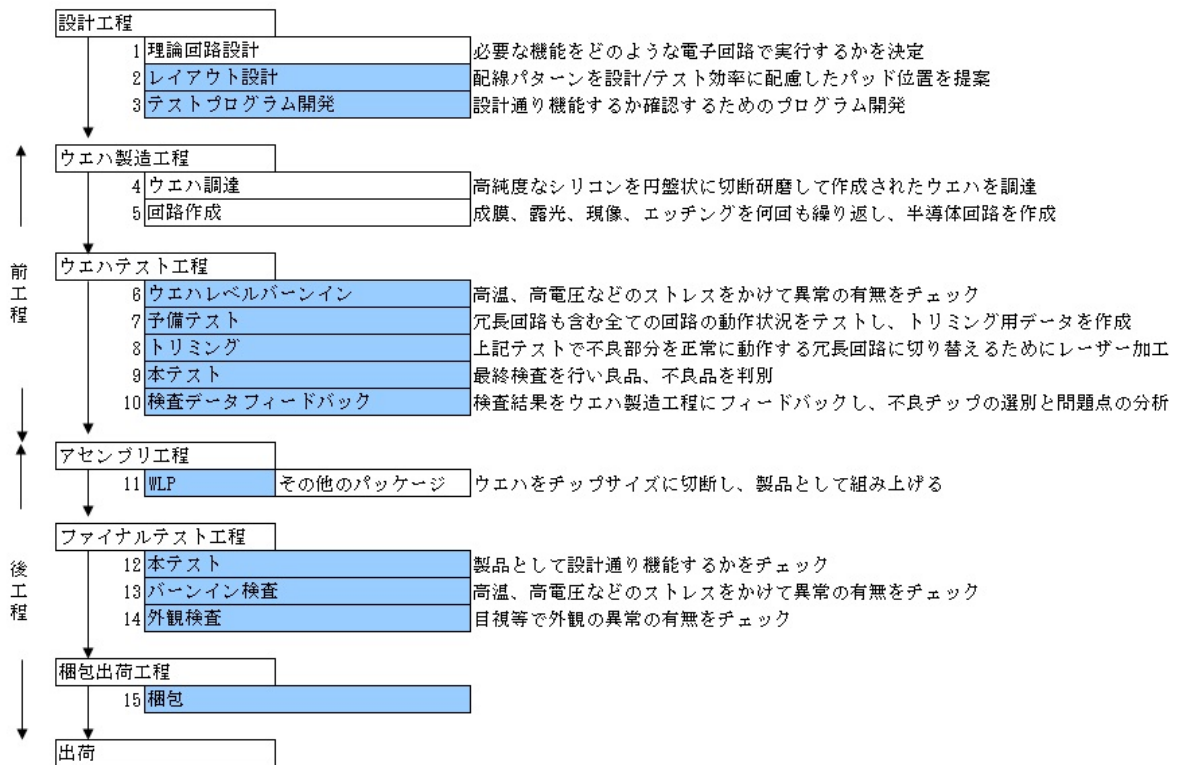
#### (2) システムLSI事業

システムLSI事業は、当社では、国内外の半導体メーカーやファブダリが生産したSoC(\*12)、イメージセンサ(\*13)、アナログ(\*14)などの半導体製品のウエハテスト業務の受託が中心で、その他にファイナルテスト業務も受託しており、主に九州事業所で行っております。また、台湾にある連結子会社のテラパワーにおいてもSoC製品のテスト業務を受託しております。さらに、テラミクロスでは、MEMSセンサやアナログ半導体などのWLPを受託しております。

システムLSI事業におけるウエハテストも、一般的には顧客から支給されたテストプログラムを使用してテストし、ウエハ上に作り込まれた半導体チップの特性について、良品・不良品の判別を行い、その結果を顧客に提供して業務が完了します。システムLSI事業における受託製品はメモリ事業と比較すると多品種少量生産の場合が多く、製品によりテスト機器やテスト環境が異なるなどの特徴があります。そのため顧客の様々なニーズに対応していく技術力と柔軟性が求められております。

株式会社テラミクロスで受託しているWLPは、製品サイズが薄く、小さいという特徴があり、ウエハ状態で全てのパッケージング工程を完了するため、高い生産性を誇ります。

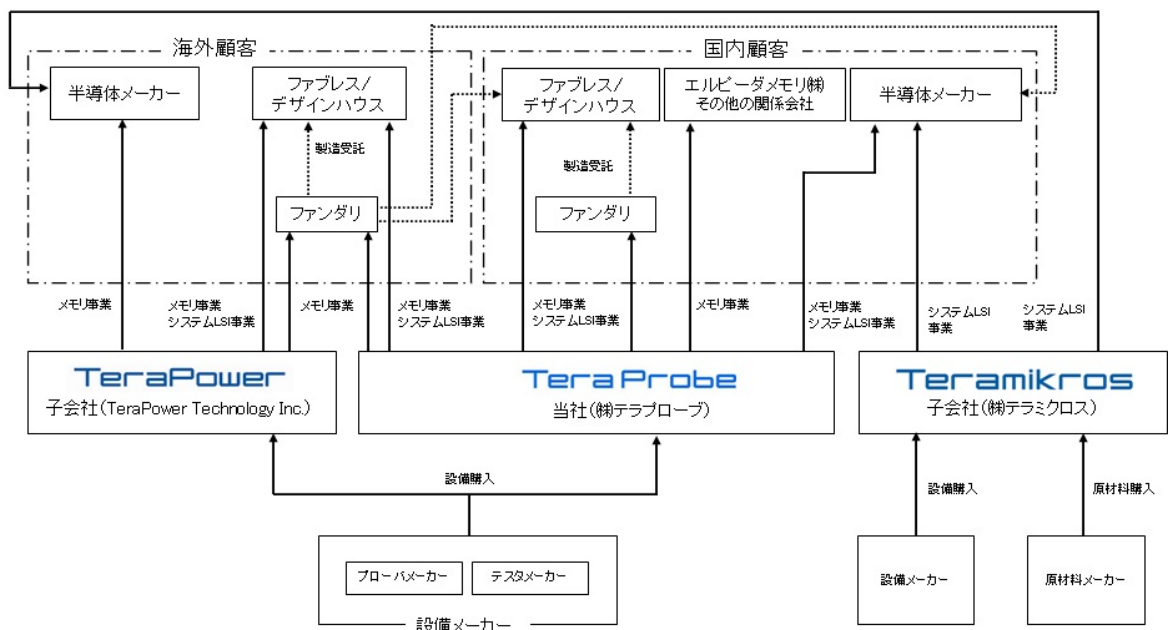
(半導体製造工程)



(注) 上記工程図内のウエハテスト工程(6~10)は、メモリ製品のウエハテスト工程を記載しております。

以上に述べた事項を事業系統図に示すと次のとおりです。

[事業系統図]





## 用語解説

- (\*1) ウェハ：ウェハは単結晶シリコンの塊（インゴット）から薄く切り出された円盤状のものの表面を研磨した薄い板で、半導体チップを製造するための直接材料となるものです。このウェハ上にトランジスタ、キャパシタ（電荷を蓄える部品：コンデンサ）、配線などを作り込み、電子回路を形成します。  
直径は200mm（8インチ）、300mm（12インチ）が一般的で、大口径化するにつれウェハ1枚当たりから取れる半導体チップ数が多くなりコストダウンにつながります。半導体チップ面積が同じであれば、300mmウェハは200mmウェハの2倍程度のチップの生産が可能です。
- (\*2) 前工程：一般的に半導体製造工程のうち、ウェハ上に半導体チップを作り込み、ウェハ状態で検査し、良品・不良品の判別をするまでの工程を指します。
- (\*3) 後工程：一般的に半導体製造工程のうち、前工程以降の半導体チップをパッケージングし、個々の半導体デバイスを検査し、不良品を除去するまでの工程を指します。
- (\*4) ダイシング：ウェハ上に作られた半導体チップを、ダイヤモンド刃のカッターなどで個々の半導体チップに切り離すことを指します。
- (\*5) パッド：半導体チップ上に形成された端子（電極）を指します。この端子に探針（プローブ）を当て、半導体の電気特性を測定します。
- (\*6) テスタ：半導体の電気特性を検査するための装置です。テストプログラムに基づき、直流、交流特性並びに機能について検査を行います。
- (\*7) プローバ：ウェハの半導体チップ上のパッドにプローブを当てるための装置です。テスタに接続して使用します。
- (\*8) プローブカード：ウェハテストでは、半導体チップ上の端子（電極）にプローブと呼ばれる探針を正確に当てることが求められます。このプローブを素早く正確に半導体チップに当てるために、半導体チップ上の端子パターンに合わせてプローブを配置し、セットにしてテストを行いやすくしたものを指します。  
カードの形状の多くは円形で、カードの周辺部にはテスト装置との接続端子、中央に半導体チップに接続するプローブが取り付けられており、プローバというテスト装置に取り付けて使用します。
- (\*9) DRAM (Dynamic Random Access Memory)：DRAMは、記憶単位が1個のトランジスタと1個のキャパシタ（電荷を蓄える部品：コンデンサ）で構成される半導体で、集積度に優れています。このためビット単価も安く、大容量のメモリを必要とするシステムを中心に使用されます。DRAMは情報をキャパシタに電荷で蓄えるため、微少の漏れ電流によって長時間放置すると情報が失われます。このため定期的に同一情報を再書き込みする必要があります。
- (\*10) MCP (Multi Chip Package)：一つのパッケージの中に、複数の半導体チップを集積したパッケージ（半導体デバイス）を指します。複数の異なる半導体チップを組み合わせることで、多様な機能を実現することができ、実装空間効率も良く、携帯電話など小型のモバイル端末等に多く用いられています。
- (\*11) ウェハレベルバーンイン：半導体デバイスの潜在的な欠陥を除去するためにパッケージ前に通常の使用状態と異なる高温状態で一定時間高電圧を加える加速試験のことを指します。
- (\*12) SoC (System on Chip)：一つの半導体チップ上に、必要とされる一連の機能（システム）を集積したものを指します。複数の機能を1チップ上に集積することで、基板上に複数の単機能LSIを実装するよりも機器自体の小型化が可能になるなどのメリットがあります。
- (\*13) イメージセンサ：画像を電気信号に変換する半導体素子を指します。デジタルカメラをはじめ、携帯電話などにも広く使用されています。CCD、CMOSなど構造によりいくつかの種類があります。
- (\*14) アナログ：無線通信用半導体や電源制御用半導体、アナログデータをデジタルデータに変換するコンバータなど多くの種類があります。

#### 4 【関係会社の状況】

名称	住所	資本金 (百万円)	主要な事業の内容	議決権の所有 割合又は被所 有割合 (%)	関係内容
(その他の関係会社) エルピーダメモリ㈱	東京都中央区	236,143	半導体素子・集積 回路の製造・販売	被所有 39.6	テスト業務受託 研究開発受託
(連結子会社) ㈱テラミクロス	東京都青梅市	300	ウエハレベルパッケ ージ受託	所有 100.0	役員の兼任3名
TeraPower Technology Inc.	台湾 新竹縣	NT\$750百万	半導体ウエハテスト 受託	所有 51.0	役員の兼任3名

(注) 1. エルピーダメモリ株式会社は平成24年2月27日に東京地方裁判所に対し会社更生手続の申立を行い、同年3月23日に会社更生手続の開始決定がなされております。

2. 株式会社テラミクロスは売上高の連結売上高に占める割合が10%を超えています。

主要な損益情報等	(1) 売上高	2,772百万円
	(2) 経常損益	△327百万円
	(3) 当期純損益	△858百万円
	(4) 純資産額	1,657百万円
	(5) 総資産額	4,444百万円

## 5 【従業員の状況】

### (1) 連結会社の状況

平成24年3月31日現在

セグメントの名称	従業員数（人）
メモリ事業	250（51）
システムLSI事業	294（96）
全社（共通）	116（13）
合計	660（160）

- (注) 1. 従業員数は就業人員（当社グループからグループ外への出向者を除き、グループ外から当社グループへの出向者を含みます。）であり、嘱託社員及び派遣社員は、当連結会計年度末までの1年間の平均人員を（ ）外数で記載しております。
2. 全社（共通）として記載されている従業員数は、特定の事業に区分できない管理部門に所属しているものであります。
3. 平成23年10月1日に株式会社テラミクロスが連結子会社となったことから、システムLSI事業における従業員数が263名、嘱託社員及び派遣社員数が37名増加しております。

### (2) 提出会社の状況

平成24年3月31日現在

従業員数（人）	平均年齢（歳）	平均勤続年数（年）	平均年間給与（円）
294（123）	37.7	3.83	6,287,726

- (注) 1. 従業員数は就業人員（当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含みます。）であり、嘱託社員及び派遣社員は、年間の平均人員を（ ）外数で記載しております。
2. 従業員のセグメント毎の内訳は以下のとおりとなります。臨時雇用者数は、年間の平均人員を（ ）外数で記載しております。
- |           |           |
|-----------|-----------|
| メモリ事業     | 165名（51名） |
| システムLSI事業 | 74名（69名）  |
| 全社（共通）    | 55名（3名）   |
3. 平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。

### (3) 労働組合の状況

労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。

## 第2【事業の状況】

### 1【業績等の概要】

#### (1) 業績

当連結会計年度の経済環境は、東日本大震災の影響が残る中、タイの洪水が発生するなど自然災害の影響による企業の生産活動の低迷や、円高の影響による輸出産業の低迷など、国内経済は厳しい状況で推移いたしました。

当社グループが属する世界の半導体市場は、震災直後に一時的な需要増加はあったものの、上記洪水により一部部品の供給が不足したほか、製品組み立てが滞るなどの原因で、半導体の生産も調整を余儀なくされ、低調に推移いたしました。

しかし、当社グループは、下期から株式会社テラミクロスが新たに連結子会社に加わったことなどにより、売上高を伸ばすことができました。

一方、当社九州事業所では平成18年の事業所開設以来、国内IDM(半導体の回路設計から製造、販売までを手掛けるメーカー)を顧客としてSoC(システム・オン・チップ)製品のウエハテストを中心にシステムLSI事業を拡大してまいりました。現在では70台を超えるテスト装置を保有し、国内トップクラスの規模となっております。しかしながら、常に市況の激しい変化にさらされ、多額の投資にもかかわらず、安定的なビジネスを確保できない状況が続き、これまで赤字を計上する状況が続いております。

この間、海外を含む新規顧客の獲得により顧客数を増やし、SoC製品から高い成長性が期待できるイメージセンサやアナログ製品など製品分野も拡大してまいりました。また、従来の顧客の繁閑に稼動を左右される形態から、より顧客とのパートナーシップを強化した安定的な稼動を確保できる形態への転換にも挑戦してまいりました。しかしながら、世界的な半導体市場の変化は早く、SoC製品から他の製品分野へのシフトは不十分な状況にあります。このような状況から、九州事業所の将来の収益性を保守的に見積もった結果、固定資産の減損処理を行うこととなりました。

このような状況により、当連結会計年度における当社グループの売上高は24,190百万円(前期比13.1%増)、営業利益は2,710百万円(同47.7%減)、経常利益2,402百万円(同50.3%減)となりました。特別利益は1,069百万円(前期は246百万円)となり、主に、平成23年10月1日に株式会社テラミクロスを株式取得により連結子会社としたことに伴う負ののれん559百万円を計上しております。一方、特別損失は8,195百万円(前期は201百万円)となり、主に、エルピーダメモリ株式会社の会社更生法申請に伴い、同社向け債権に対して計上した貸倒引当金2,701百万円、当社九州事業所で保有している固定資産の減損処理に伴う減損損失として5,388百万円を計上しております。これらの結果、当期純損益は5,529百万円の損失(前期は4,151百万円の利益)となりました。この業績を真摯に受け止め、常勤取締役及び執行役員報酬を平成24年1月から3月まで最大20%減額しておりましたが、この減額措置を平成24年6月まで延長いたしました。また、管理職の賞与についても減額いたしました。

セグメント別の業績は以下のとおりであります。なお、セグメント別の業績には連結調整額、為替換算レート調整額及びセグメント別に配分されない費用を含んでおりません。

#### (メモリ事業)

メモリ事業におきましては、DRAM市場の悪化に伴い当社のテスト受託も期初の予想ほどの伸びがなかったことなどから、昨年度から当年度上期にかけて行った設備投資にともなう償却費の増加をカバーすることができませんでした。また、DRAM以外のメモリ製品につきましても、受託量が減少し、低調に推移いたしました。

これらの結果、当連結会計年度のメモリ事業の売上高は19,745百万円(前期比0.7%増)、セグメント利益は4,970百万円(同30.2%減)となりました。

#### (システムLSI事業)

システムLSI事業におきましては、既存の受託製品では上記洪水の影響やデジタル家電の販売不振に伴い、顧客の生産調整があったこと及び新規受託を見込んでいた製品の生産がずれ込んだことなどにより低調に推移いたしました。

しかし、新規顧客の獲得や新規製品の受託もあり、また、新たに連結子会社となった株式会社テラミクロスの売上も加わり、売上高は大幅に増加いたしました。利益面では既存製品の受託減少を補うまでには至りませんでした。

これらの結果、当連結会計年度のシステムLSI事業の売上高は4,529百万円(前期比154.1%増)、セグメント損益は998百万円の損失(前期は872百万円の損失)となりました。

(2) キャッシュ・フロー

当連結会計年度末の現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は5,557百万円となり、前連結会計年度末比1,653百万円の減少（前年同期比22.9%減）となりました。

当連結会計年度のキャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動によるキャッシュ・フローは、9,813百万円の純収入（前年同期比5.5%の収入減）となりました。これは主に、減価償却費の計上9,219百万円、システムLSI事業における減損損失の計上5,388百万円、エルピーダメモリ株式会社の会社更生法申請に伴い破産更生債権等に対し計上した貸倒引当金2,701百万円などにより資金が増加しましたが、一方で、税金等調整前当期純損失の計上4,723百万円、法人税等の支払1,256百万円により資金が減少したことによるものです。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動によるキャッシュ・フローは、10,671百万円の純支出（前年同期比25.5%の支出増）となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出10,629百万円によるものです。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動によるキャッシュ・フローは、804百万円の純支出（前年同期は2,532百万円の純収入）となりました。これは主に、リース債務の返済による支出6,699百万円と、セール・アンド・リースバック取引による収入5,895百万円によるものです。

(参考) キャッシュ・フロー 関連指標の推移

	平成22年3月期	平成23年3月期	平成24年3月期
自己資本比率 (%)	49.9	49.5	47.1
時価ベースの自己資本比率 (%)	—	43.3	19.5
キャッシュ・フロー対有利子負債比率 (年)	1.35	1.52	1.36
インタレスト・カバレッジ・レシオ (倍)	29.9	44.3	38.9

自己資本比率：自己資本／総資産

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー

インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い

(注) 1. いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。

2. 平成22年3月期の時価ベースの自己資本比率は、株式時価総額が算定不能ですので記載しておりません。

3. キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しております。

4. 有利子負債は連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っているすべての負債を対象としております。

## 2 【生産、受注及び販売の状況】

### (1) 生産実績

当社グループの生産品は全て入庫後すぐに顧客のもとへ出荷されているため、生産実績は販売実績とほぼ同額となります。従いまして、生産実績の記載はしておりません。下記 (3) 販売実績をご参照ください。

### (2) 受注状況

当社グループの取引形態においては、当月の受注のほとんどが、同月中に出荷完了しているため、受注実績は販売実績とほぼ同額となります。従いまして、受注状況の記載はしておりません。下記 (3) 販売実績をご参照ください。

### (3) 販売実績

当連結会計年度の販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称	当連結会計年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)	
	金額 (千円)	前年同期比 (%)
メモリ事業	19,745,878	0.7
システムLSI事業	4,529,212	154.1
調整額 (注1)	△84,975	—
合計	24,190,114	13.1

(注) 1. 調整額は、円換算に用いた為替相場の相違による差異調整額、及び連結消去であります。

2. 当連結会計年度の前連結会計年度及び当連結会計年度の主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は、次のとおりであります。

相手先	前連結会計年度 (自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)		当連結会計年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)	
	金額 (千円)	割合 (%)	金額 (千円)	割合 (%)
エルピーダメモリ㈱	15,094,109	70.6	16,025,269	66.2

3. 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

### 3 【対処すべき課題】

当社グループの主要な取引先であるエルピーダメモリ株式会社においては、再建に向けた更生手続が開始されたものの、更生計画の認可までには至っていないという状況にあるため、当社には、継続企業的前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在しており、現時点では継続企業的前提に関する重要な不確実性が認められます。

当社グループでは、特定の取引先に売上高が偏っている状況を変え、より強固な財務体質を築くために、以下のような施策を実行してまいります。

なお、エルピーダメモリ株式会社の更生計画が認可され、当社へのウエハテスト業務委託が継続される場合には、このような不確実性は解消すると考えております。

#### (1) システムLSI事業の収益改善

今後は、製品ごとの収益性をより精査し、採算性の低い製品については受託の可否を検討し、低稼働の設備についてはそのあり方を見直してまいります。また、新しい製品の受託にあたっては投資リスクを今まで以上に精査し、顧客とのWin-Winの関係を目指します。さらに、連結子会社である株式会社テラミクロスが行うWLP(ウエハレベルパッケージ)の省スペース性を武器に、成長しているスマートフォンなどのモバイル製品に搭載される半導体のウエハテストとWLPの受託に注力し、テストとWLPを一貫して提供するターンキーソリューションによる事業拡大を目指してまいります。

コスト削減については、すでに役員報酬の削減を実施しておりますが、これに加えて管理職の賞与削減、外部委託の見直し等により一層のコスト削減を徹底してまいります。

#### (2) 資金調達の検討、実施

当社グループでは、財務基盤の安定化のために、様々な資金調達策を検討し、実施してまいります。また、保有設備の選別を進め、低稼働資産の売却を促進してまいります。

#### 4【事業等のリスク】

本書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項には、以下のようなものがあります。

なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。

(1) 当社の主要顧客であり、大株主であるエルピーダメモリ株式会社の会社更生法適用について

当社の主たる株主であり、当社グループ売上高の約66%を占める主要顧客でもあるエルピーダメモリ株式会社は、平成24年2月27日に東京地方裁判所に対し会社更生手続開始の申し立てを行い、平成24年3月23日に同裁判所よりエルピーダメモリ株式会社に対し会社更生手続開始決定がなされました。

エルピーダメモリ株式会社は、会社更生手続開始の申し立て後もDRAM事業を継続しており、当社は引き続き申し立て以前と同レベルのウエハテスト業務を同社より受託しております。しかし、当連結会計年度末現在ではエルピーダメモリ株式会社の再建に向けた更生手続が開始されたものの、更生計画の認可までには至っていないという状況にあるため、エルピーダメモリ株式会社の将来に関する不確実性を当社が完全に排除することは困難であります。当該状況により、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在しております。

エルピーダメモリ株式会社の会社更生計画が認可されない、あるいは会社更生手続がうまくいかない場合、当社グループの経営成績に悪影響を及ぼす可能性があります。

(2) エルピーダグループ(エルピーダメモリ株式会社及びその子会社)との関係について

① 資本関係について

当連結会計年度末現在における当社の総株主の議決権のうち39.64%をエルピーダメモリ株式会社が保有しており、当社はエルピーダメモリ株式会社の関連会社であります。

大株主としてのエルピーダメモリ株式会社による当社株式の株主権行使が、当社の他の株主の利益と一致しない可能性があります。

② エルピーダグループとの取引について

前連結会計年度及び当連結会計年度における当社グループとエルピーダグループとの間の取引は以下のとおりであります。これらの取引は、当社グループとエルピーダグループとの取引関係の変化又は取引条件の変化によって、その内容や規模が変動し、又は終了する可能性があります。

a. エルピーダメモリ株式会社

		前連結会計年度 (自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)	取引内容	取引条件
		金額(千円)	金額(千円)		
収益	売上	14,527,459	15,615,319	テスト受託売上 (製品の販売)	総コストを勘案して交渉により決定
	売上	566,650	409,950	開発受託売上	プログラム開発等は、開発者工数単金を市場価格並みで設定。生産性向上支援については、総コストを勘案して交渉により決定
	人件費	795	211	生産情報収集業務等に係る人件費請求	作業者の時間当たり人件費相当
	雑益	7,975	-	環境構築費当社立替請求	実費請求
費用	人件費	5,830	-	出向者人件費	出向者人件費実費負担。 平成22年11月をもって終了
	厚生費	2,259	-	食堂利用料	エルピーダメモリ(株)広島工場食堂での社員以外利用料金とエルピーダメモリ(株)社員向け価格との差額分について当社社員利用額に応じた負担
	厚生費	-	464	エルピーダメモリ(株)が開催する行事の参加費	当社からの参加者数に応じた参加費用負担。



		前連結会計年度 (自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)	取引内容	取引条件
		金額 (千円)	金額 (千円)		
費用	通勤費	3,846	4,409	バス利用料	エルピーダメモリ(株)社員用通勤バスについて当社社員利用分について公共交通機関の料金に準じた負担
	購入消耗品	6,116	7,892	破損製品購入	受託測定時に発生した当社起因による破損した製品の製造コスト相当額での購入
	通信費	2,894	2,415	電話代	広島事業所で使用したNTT電話料についてエルピーダメモリ(株)立替分を実費負担
	技術外注費	769	-	Officeソフトライセンス料	Officeソフトライセンス料について当社負担分のエルピーダメモリ(株)立替分実費負担。平成22年5月をもって終了
	業務委託料	136,174	117,062	広島工場での施設管理委託、安全衛生・警備委託等	対象業務に係る人件費相当及び当社に關係する実費について人員比等で案分した当社負担分
	不動産賃借料	339,201	332,698	広島工場クリーンルーム、事務所賃借料	対象資産の償却費に固定資産税、保険料、金利相当額等を加えた賃借料負担
	動産賃借料	246,994	249,130	電力・空調供給設備、生産設備等賃借料	対象資産の償却費に固定資産税、保険料、金利相当額等を加えた賃借料負担
	用力費	1,165,262	1,416,600	電気料金、ガス、水道代	当社使用量に応じたエルピーダメモリ(株)立替分実費負担
	支払修繕費	631	1,135	電話機増設代	広島事業所で使用する電話機の増設について当社負担分のエルピーダメモリ(株)立替分実費負担
	会議費	2,601	1,088	会議室利用料	会議室の利用時間に応じた負担
	雑 損	-	54,233	損害賠償金	破損した製品相当額の負担

		前連結会計年度 (自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)	取引内容	取引条件
		金額 (千円)	金額 (千円)		
設備の売却	120,880	-	-	測定設備の売却	対象資産の売却時点の簿価に設備移設に必要な経費等を加えた価格
資産の売却	-	-	301,650	プロンプカードの売却	対象資産の売却時点の簿価に必要な経費等を加えた価格
設備の購入	26,300	-	-	測定設備の購入	対象資産の購入時点の簿価に設備移設に必要な経費等を加えた価格

(注) 上記は取引毎に総額で表示しておりますので、財務諸表における表示・開示と異なる場合があります。

b. 秋田エルピーダメモリ株式会社

	前連結会計年度 (自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)	取引内容	取引条件
	金額 (千円)	金額 (千円)		
売上	-	72	テスト受託	総コストを勘案して交渉により決定
設備の売却	142,200	-	測定設備の売却	対象資産の売却時点の簿価に設備移設に必要な経費等を加えた価格

c. Rexchip Electronics Corporation

	前連結会計年度 (自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)	取引内容	取引条件
	金額 (千円)	金額 (千円)		
売上	511,861	843,396	テスト受託	総コストを勘案して交渉により決定
設備の売却	-	500	生産設備の売却	対象資産の売却時点の簿価に設備移設に必要な経費等を加えた金額
立替金の入金	692	-	梱包資材当社立替分の入金	実費請求

(3) 主要な事業活動の前提となる契約について

当社グループは、エルピーダメモリ株式会社との間で「ウエハテスト委託に関する基本合意書」を締結しております。当該基本合意書では、エルピーダメモリ株式会社からのウエハテストの具体的な受託の条件については、両社で協議の上定めることとなっており、委託量・委託割合等が確約されているものではなく、当該基本合意自体も、当社がエルピーダメモリ株式会社からの要求事項を満たせない状況となった場合においては終了される可能性があり、ウエハテスト受託量の大幅な変動等、当社グループの経営成績に悪影響を及ぼす可能性があります。

また、上記基本合意書においては、当社の経営状況が一定程度以上悪化した場合において、当社がエルピーダメモリ株式会社から受託するウエハテストを実行するのに必要な設備を処分・売却しようとするときにおいて、エルピーダメモリ株式会社は、他の売却先候補と同等以上の条件を提示すれば、当該設備を取得できることが定められており、これによって、当該設備の売却条件が影響を受ける可能性があります。同等以上の条件が前提であるためそのような影響は限定されると考えられます。

当連結会計年度の当社グループにおけるエルピーダメモリ株式会社向け売上の割合は、66.2%となっております。この取引は、エルピーダメモリ株式会社との間で締結している「基本契約書」及び「ウエハテスト委託に関する基本合意書」に基づいており、これらの契約は当社の主要な事業活動の前提となっております。

「基本契約書」の契約期間は平成17年10月1日から平成18年9月30日までであり、その後は1年ごとの自動更新となっており、契約の内容は取引の一般的、基本的な事項を定めたものであります。

「ウエハテスト委託に関する基本合意書」の契約期間は、平成22年3月1日から平成27年2月28日までであり、それ以後は2年ごとの自動更新となっております。当該契約において、エルピーダメモリ株式会社の生産するウエハのテストについて、当社の提供する品質、価格等が競争力を有すること等を条件として、継続的かつ安定的な本業務の履行確保の必要性を考慮して別途両者が協議し合理的に定める範囲で、当社が受託する旨合意しております。しかし、エルピーダメモリ株式会社からのウエハテストの具体的な受託の条件については、両社で協議の上定めることとなっており、受託量・受託割合等が確約されているものではなく、当該基本合意自体も、当社がエルピーダメモリ株式会社からの要求事項を満たせない状況となった場合においては更新されない可能性があります。現時点において、当社はこれらの条件を満たしておりますが、将来これらの条件を満たせない状況が発生した場合、ウエハテスト受託量が大幅に減少するなど、当社グループの経営成績に悪影響を及ぼす可能性があります。

(4) 経済状況について

当社グループの属する半導体業界が生産する製品は、PCをはじめ、携帯電話、デジタル家電など幅広い分野で使用されており、平成20年の金融危機のように市場でこれらの最終製品の販売状況が急激に悪化した場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

また、当社グループの受託品のうち負荷が高い製品と低い製品の比率が大きく変動した場合や、受託量が大きく減少した場合、当社グループの保有するテスト装置の稼働率が急激に低下し、経営成績に悪影響を及ぼす可能性があります。

(5) 技術革新による影響について

当社グループの属する半導体業界は、製品の高機能化、低価格化が急激に進行する技術革新の速度が非常に速いという特徴があります。このため、画期的な技術開発がなされた場合、当社の保有する設備、技術が陳腐化する可能性があります、その場合、当社の事業展開、財政状態及び経営成績に悪影響を及ぼす可能性があります。

(6) 特定顧客への依存について

当社グループは、エルピーダメモリ株式会社を主要顧客として事業を展開しております。当社グループにおけるエルピーダグループへの売上比率の推移は以下のとおりとなっております。

	平成22年 3 月期	平成23年 3 月期	平成24年 3 月期
売上比率	74.6%	73.0%	67.5%
内、エルピーダメモリ(株)分	72.1%	70.6%	66.2%

エルピーダメモリ株式会社が会社更生法による事業の再建を目指す過程で生産数量や生産品種の見直しを行うことにより、当社グループへのテスト業務の委託を大きく減少させた場合には、当社グループの事業展開、財政状態及び経営成績に悪影響を及ぼす可能性があります。

また当社グループがテスト業務を受託しているその他の主要顧客のいずれかが、当社グループへのテスト業務の委託を大きく減少させた場合、又は何らかの理由により顧客の事業環境に大きな変化が生じた場合等には、当社グループの事業展開、財政状態及び経営成績に悪影響を及ぼす可能性があります。

(7) 人材及び業務委託先等の確保・育成・活用等について

半導体業界においては、マネジメント、技術、マーケティング及び営業その他において高い能力を有する人材を獲得するための厳しい競争があります。また、当社業務の一部を委託している業務委託先や請負先につきましても、当社の要求に対する技術対応力や処理能力、生産能力での対応力などが必要であります。当社グループが適時に適切な人材を確保・育成・維持し、活用できない場合、また当社グループが取引している上記契約先との契約を継続できない、あるいはそれらの契約先が当社の要求に応えられない場合には、当社グループの事業展開、財政状態及び経営成績に悪影響を及ぼす可能性があります。

(8) 知的財産権について

技術的差別化が競争力の向上にとって重要な半導体産業において、当社グループは主にウエハテスト及びWLPにおける最先端分野での技術開発力の向上がきわめて重要な課題の一つであると認識しております。技術力の向上のためには、国内外において自ら知的財産権を保有するとともに、第三者が保有する知的財産権についても実施許諾を受ける必要がある場合があります。当社グループが特許等の知的財産権を取得しようとする場合に、適時に出願中の特許等の登録を受けられるとは限りませんし、あるいは当社グループが必要とし、第三者が保有する知的財産権についての実施許諾を適時に受けられ、かつ継続できるとは限りません。また、半導体産業のような技術主導型産業においては、特許他の知的財産権に関する訴訟ないし紛争がしばしば起こります。当社グループも第三者から知的財産権の侵害や、実施許諾等に関する違反を主張される可能性があります。又は、当社グループが保有する知的財産権が第三者に侵害される可能性があります。このような場合、当社グループの事業展開、財政状態及び経営成績に悪影響を及ぼす可能性があります。

(9) 品質について

当社グループは顧客からのテスト受託に当たり、要求された品質を満たすべく注力しております。しかしながら、顧客の要求するテスト品質を満たせない状況が発生した場合、顧客の信用を失い、テスト業務の受託が極端に減少する可能性があります、その場合、当社グループの経営成績に悪影響を及ぼす可能性があります。

(10) 情報管理について

当社グループは顧客からのテスト受託に当たり、テストプログラムなど顧客の重要情報を取り扱っております。これらの重要情報の取り扱いについては細心の注意を払い、情報管理を徹底しておりますが、情報漏洩等が発生した場合、顧客の信用を失い、テスト業務の受託が極端に減少する可能性があり、その場合、当社グループの経営成績に悪影響を及ぼす可能性があります。

(11) 顧客資産管理について

当社グループは顧客の製品であるウェアや顧客の資産であるプロブカード等の支給を受けて業務を行っております。これらの製品及びプロブカード等は高価であり、その扱いには細心の注意を払っておりますが、事故等これらを破損した場合、その損害を賠償することとなります。当社グループは、保険契約によりこれら受託品の事故に対して備えておりますが、全ての補償を可能にするものではなく、事故等の発生により当社グループの財政状態及び経営成績に悪影響を及ぼす可能性があります。

また、顧客の資産を破損した場合、顧客の信用を失い、テスト業務の受託が極端に減少する可能性があり、その場合、当社グループの経営成績に悪影響を及ぼす可能性があります。

(12) 自然災害等について

当社グループの事業拠点は、神奈川県横浜市港北区、広島県東広島市、熊本県葦北郡芦北町及び台湾新竹縣に立地しており、当地及びその周辺で地震、台風等の自然災害、事故又はその他当社グループがコントロールできない事象が発生した場合、操業の停止等様々な損害を受ける可能性があります。当社グループは損害保険に加入しておりますが、考える全ての損失について保険に加入しているわけではなく、当社グループの受ける損失の全てが保険により補填される保証はありません。また、主として地震による被害を想定し、速やかな事業再開を図るため、いわゆる事業継続計画(BCP)を策定しておりますが、被災の影響の全てを吸収したり、想定どおりの事業再開が行える保証はありません。そのため、上記のような当社グループがコントロールできない事象が発生した場合、当社グループの事業展開、財政状態及び経営成績に重大な悪影響を及ぼす可能性があります。

今回の東日本大震災では、当社グループの人員及び設備に特段の影響はありませんでした。しかし、当社グループの一部顧客では被災により生産が停止したほか、原材料の生産の一部が停止するなど、その影響は多方面にわたっており、これらの影響が当社グループの経営成績に悪影響を及ぼす可能性があります。

(13) 生産設備等について

当社グループは、生産設備等について、供給に関連する問題の発生を回避するため、複数の供給者と緊密な関係を構築するように努めております。しかし、設備・治具等の中には特定の供給元からしか入手できないものも含まれているため、需給が逼迫した場合の供給能力不足や供給元の事故等により、これらを適切なタイミングで調達できない可能性があります。また調達できる場合でも調達価格が大幅に上昇するなど、当社グループの事業活動に支障が生じ、当社の事業展開、財政状態及び経営成績に悪影響を及ぼす可能性があります。

(14) 金利変動による影響について

当社は、多額な設備投資用の資金調達手段として金融機関からの借入や割賦、ファイナンス・リース、オペレーティング・リースを利用しております。このため、金利をはじめ市場全体の信用収縮など資金調達条件に影響する要素に著しい変動が生じた場合、当社グループの事業展開、財政状態及び経営成績に悪影響を及ぼす可能性があります。

(15) 為替相場の変動による影響について

当社グループは、売上の一部及び設備購入の一部について外貨建取引を行っており、為替予約により為替相場の変動を緩和すべく対策を講じておりますが、為替相場が大幅に変動した場合、当社グループの経営成績に悪影響を及ぼす可能性があります。

(16) 財務制限条項について

当社の借入金については、財務制限条項がついており、下記の条項のいずれかに抵触した場合、当社は期限の利益を喪失し、該当する借入先に対して借入金を一括して返済することになっております。

- ①各事業年度の末日における純資産の部の金額が7,824百万円未満となった場合。
- ②各事業年度の決算期末(本決算)において損益計算書の当期純損益が2期連続で純損失となった場合。

当該条項に抵触した場合、当社グループの財政状態に悪影響を及ぼす可能性があります。

(17) ストックオプションによる株式の希薄化について

当社は、当社の役員及び従業員に対して、当社に対する経営参画意識を高め、業績向上に対する意欲や士気を喚起することを目的として、ストックオプションによる新株予約権の発行を行っております。平成24年6月26日現在における新株予約権による潜在株式数は485,200株であり、発行済株式総数9,282,500株の5.2%に相当します。これらの新株予約権が行使された場合、発行済株式総数が増加し、1株当たりの株式価値が希薄化する可能性があります。

なお、ストックオプションの詳細につきましては、「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2) 新株予約権等の状況」をご参照ください。

(18) 配当について

当社は、株主に対する利益還元を経営の最重要課題と位置づけておりますが、当連結会計年度末時点では利益剰余金がマイナスとなったため、財務基盤の強化を優先し、配当等の利益還元を実施しておりません。今後、利益剰余金がプラスとなれば、配当を実施していく予定であります。業績の推移や経済環境の急激な変動によって配当できなくなる可能性があります。

当社の配当政策の詳細については、「第4 提出会社の状況 3 配当政策」をご参照ください。

(19) 資金について

当社グループの事業は設備投資に多額の資金が必要であり、現状の事業計画においても新たなビジネスの獲得に伴う設備投資が予定されています。これらの設備投資に関して、必要な資金の調達が可能であると判断しておりますが、当社の主要顧客の再建計画によっては、当社業績が大きく影響を受ける可能性があることや経済環境の急激な変動等により予定していた資金調達が出来なくなった場合、当社グループの事業展開、財政状態及び経営成績に悪影響を及ぼす可能性があります。

## 5 【経営上の重要な契約等】

### (1) 半導体テストサービスに関する契約

契約会社名	契約締結先	内容	契約締結日	契約期間
(株)テラプローブ	エルピーダメモリ(株)	取引基本契約 (注)1	平成17年10月1日	平成17年10月1日から平成18年9月30日まで以後1年ごとの自動更新
(株)テラプローブ	エルピーダメモリ(株)	開発委託基本契約 (注)2	平成17年10月1日	平成17年10月1日から平成20年9月30日まで以後1年ごとの自動更新
(株)テラプローブ	エルピーダメモリ(株)	ウエハテスト委託に関する基本合意 (注)3	平成22年4月28日	平成22年3月1日から平成27年2月28日まで以後2年ごとの自動更新

(注) 1. 当契約の内容は取引の一般的、基本的な事項を定めたものであります。

2. 当契約の概要は以下のとおりです。

当社はエルピーダメモリ株式会社が生産する半導体の検査に関する技術開発について受託することで合意しております。当契約に基づき新たに生じた知的財産はエルピーダメモリ株式会社に帰属する旨合意しております。

3. 当契約の概要は以下のとおりです。

当社とエルピーダメモリ株式会社はエルピーダメモリ株式会社が生産するウエハのテストについて、当社の提供する品質、価格等が競争力を有することを条件として継続的かつ安定的な当該テストの履行確保の必要性を考慮して別途両者が協議し合理的に定める範囲で、当社が受託する旨合意しております。また、当社の業績が著しく悪化した状況において、エルピーダメモリ株式会社からのウエハテストを受託するために必要な設備を当社が売却する場合には、購入を希望する第三者と同等以上の条件でエルピーダメモリ株式会社が当該設備を購入することが出来る旨合意しております。

### (2) 合弁会社設立に関する契約

契約会社名	契約締結先	内容	出資額	合弁会社名	契約締結日
(株)テラプローブ	Powertech Technology Inc. (PTI)	ウエハテスト事業の合弁会社設立	当社 382.5百万台湾ドル PTI 367.5百万台湾ドル	TeraPower Technology Inc.	平成20年7月30日

(注) 合弁会社設立に合わせ、Powertech Technology Inc. より、ウエハテストに関する事業を549,626千台湾ドルで譲り受けております。

### (3) 株式譲渡に関する契約

契約会社名	契約締結先	内容	取得価額	株式を取得する会社の名称	契約締結日
(株)テラプローブ	カシオ計算機(株)	株式譲渡契約	600百万円	(株)テラミクロス	平成23年6月17日

(注) 当社は、平成23年6月17日開催の取締役会において、カシオ計算機株式会社が平成23年7月20日に設立し、カシオ計算機株式会社の連結子会社であるカシオマイクロニクス株式会社のWLP(Wafer Level Package)関連事業を主とする全事業に関する資産・負債等（カシオ計算機株式会社に対する借入債務等を除きます。）及び当該事業に関連してカシオ計算機株式会社が保有する資産・負債等を承継する新会社（株式会社テラミクロス）の発行済株式すべてを当社が譲り受けること（以下、本注記において「本件株式取得」といいます。）について決議し、同日、カシオ計算機株式会社との間で本件株式取得に係る株式譲渡契約を締結いたしました。なお、当該株式譲渡契約に基づいて、平成23年10月1日に同社の全株式を取得しております。

## 6 【研究開発活動】

当社グループでは半導体テストの受託及びWLPの受託を主力事業としており、研究開発活動はテスト技術及びWLPに関するものに集中しております。また、当社独自の取り組みよりも、テスト受託に関連した開発内容が中心であることが当社の研究開発活動の特徴となっております。

半導体製品の微細化・高機能化に伴い、テスト技術についても多くの新たな開発案件が出てきており、顧客の要求の実現とビジネス拡大のためには研究開発活動が益々重要となってきました。先端テストに関する研究開発が顧客とのパートナーシップ構築に不可欠となっております。

また、モバイル機器の普及により、半導体製品の小型化、薄型化が重要となっており、WLPも他品種化に対応するための多ピン化並びに基盤内蔵WLPなどへの対応が必要となっております。

当連結会計年度における各セグメント別の研究の目的、主要課題、研究成果及び研究開発費は次のとおりであります。

### (1) メモリ事業

メモリ事業における研究開発の目的は、顧客製品の微細化、高機能化に対応するテスト技術の開発であります。

主要な課題としては、微細化によるチップ数の増加に対して、テストコストの増加を抑えることであります。この研究成果として、同時測定数を増加することで、テスト時間の増加を最小限に抑えることが可能となり、さらに、レーザー加工の高効率化などにより設備投資を最小限に抑えつつ処理能力を向上させることが可能となりました。

但し、これらの研究開発は事業活動に密接に関わる内容であるため、売上原価として処理しており、研究開発費は計上しておりません。

### (2) システムLSI事業

システムLSI事業における研究開発の目的は、新規製品分野のテスト受託のためのテスト技術確立及び基盤内蔵WLPの製品化であります。

主要な課題の一つ目としては、アナログ製品の新規受託に向けたテスト技術を確立することです。この研究成果として、新たにアナログ製品のテスト技術を確立し、新規顧客からの受託を開始することが出来ました。

二つ目としては、基盤内蔵WLPの製品化に向けた開発を基盤メーカーと協力して推進しております。

但し、これらの研究開発は事業活動に密接に関わる内容であるため、その多くを売上原価として処理しており、研究開発費としては38百万円を計上しております。

## 7【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。

### (1) 重要な会計方針及び見積り

当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づき作成されております。その作成には、経営者による会計方針の選択・適用、資産・負債及び収益・費用の報告金額及び開示に影響を与える見積りを必要とします。経営者は、これらの見積りについて過去の実績等を勘案し合理的に判断しておりますが、実際の結果は、見積り特有の不確実性があるため、これらの見積りと異なる場合があります。

#### ① 繰延税金資産

当社グループは、繰延税金資産の回収可能性を検討し、評価性引当金を設定することにより減額しております。評価性引当金の必要性を検討するに当たり、将来の課税所得を考慮しております。繰延税金資産の回収可能性の検討は毎期行っており、計上されている繰延税金資産の金額と回収見込み金額との差額は、法人税等調整額に計上され、当期純利益を増減させることとなります。

#### ② 固定資産の減損

当社グループでは、「固定資産の減損に係る会計基準」を適用しており、当連結会計年度において帳簿価額の回収が困難と見込まれる固定資産につき減損処理を行っております。なお、前述以外の固定資産については、将来の収益計画に基づき減損処理の必要性を判断していますが、将来の収益獲得が見込めなくなった場合には、減損損失が発生する可能性があります。

#### ③ 退職給付債務

当社の従業員退職給付債務及び費用は、割引率等数理計算上で設定される前提条件や年金資産の期待収益率に基づいて算出しております。実際の結果が前提条件と相異した場合又は前提条件を変更した場合、その影響額は数理計算上の差異として認識し、将来にわたり均等に償却することから、退職給付債務及び費用に影響を及ぼします。

#### ④ 貸倒引当金

当社グループは、債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、破産更生債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、貸倒引当金を計上しております。なお、相手先の財政状態の悪化により支払能力が低下した場合、引当金の追加計上が必要になる場合があります。

### (2) 経営成績の分析

当連結会計年度の経済環境は、東日本大震災の影響が残る中、タイの洪水が発生するなど自然災害の影響による企業の生産活動の低迷や、円高の影響による輸出産業の低迷など、国内経済は厳しい状況で推移いたしました。

当社グループが属する世界の半導体市場は、震災直後に一時的な需要増加はあったものの、上記洪水により一部部品の供給が不足したほか、製品組み立てが滞るなどの原因で、半導体の生産も調整を余儀なくされ、低調に推移いたしました。

しかし、当社グループは、下期から株式会社テラミクロスが新たに連結子会社に加わったことなどにより、売上高を伸ばすことができました。

#### (売上高)

当連結会計年度における売上高は、24,190百万円となり、前連結会計年度と比較して2,808百万円の増加となりました。その主な要因は、システムLSI事業におきまして、株式会社テラミクロスのWLPの売上が下期から加わったことによるものです。

#### (売上原価)

当連結会計年度における売上原価は、19,395百万円となり、前連結会計年度と比較して4,863百万円の増加となりました。その主な要因は、減価償却費が増加したこと及びシステムLSI事業におきまして、株式会社テラミクロスの売上原価が下期から加わったことによるものです。

#### (販売費及び一般管理費)

当連結会計年度における販売費及び一般管理費は、2,084百万円となり、前連結会計年度と比較して417百万円の増加となりました。その主な要因は、システムLSI事業におきまして、株式会社テラミクロスの販売費及び一般管理費が加わったことによるものです。

#### (営業利益)

上記の諸要因により、当連結会計年度における営業利益は、2,710百万円となり、前連結会計年度と比較して2,471百万円の減少となりました。



(営業外収益)

当連結会計年度における営業外収益は、167百万円となり、前連結会計年度と比較して99百万円の増加となりました。その主な要因は、受取補償金を計上したことによるものです。

(営業外費用)

当連結会計年度における営業外費用は、475百万円となり、前連結会計年度と比較して61百万円の増加となりました。その主な要因は、支払補償費を計上したことによるものです。

(経常利益)

上記の諸要因により、当連結会計年度における経常利益は、2,402百万円となり、前連結会計年度と比較して2,433百万円の減少となりました。

(特別利益)

当連結会計年度における特別利益は、1,069百万円となり、前連結会計年度と比較して823百万円の増加となりました。その主な要因は、平成23年10月1日に株式会社テラミクロスを株式取得により連結子会社としたことに伴う負ののれん559百万円を計上したこと及び地方自治体助成金の増加によるものです。

(特別損失)

当連結会計年度における特別損失は、8,195百万円となり、前連結会計年度と比較して7,993百万円の増加となりました。その主な要因は、エルピーダメモリ株式会社の会社更生法申請に伴い、同社向け債権に対して計上した貸倒引当金2,701百万円、当社九州事業所で保有している固定資産の減損処理に伴う減損損失として5,388百万円を計上したことによるものです。

(当期純利益)

上記の諸要因により、当連結会計年度における当期純損失は、5,529百万円（前連結会計年度は4,151百万円の利益）となりました。

(3) 財政状態に関する分析

(資産)

当連結会計年度末における総資産は41,088百万円となり、前連結会計年度末比9,236百万円の減少となりました。これは主に、エルピーダメモリ株式会社の会社更生法申請に伴い破産更生債権等に対して貸倒引当金2,701百万円を計上したこと、システムLSI事業の固定資産に対して減損損失5,388百万円を計上したこと及び設備代金の支払い等により現金及び預金が1,653百万円減少したことによるものです。

(負債)

負債は19,890百万円となり、前連結会計年度末比3,877百万円の減少となりました。これは主に、リース債務が2,393百万円減少し、未払金が設備購入代金の支払い等により2,517百万円減少しましたが、支払手形及び買掛金が694百万円増加したことによるものです。

(純資産)

純資産は21,198百万円となり、前連結会計年度末比5,359百万円の減少となりました。これは主に、当期純損失の計上により利益剰余金が5,529百万円減少したことによるものです。これらの結果、自己資本比率は47.1%となり、前連結会計年度末比2.4ポイント減少いたしました。

(4) キャッシュ・フローの状況に関する分析

当連結会計年度末の現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は5,557百万円となり、前連結会計年度末比1,653百万円の減少（前年同期比22.9%減）となりました。

当連結会計年度のキャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動によるキャッシュ・フローは、9,813百万円の純収入（前年同期比5.5%の収入減）となりました。これは主に、減価償却費の計上9,219百万円、システムLSI事業における減損損失の計上5,388百万円、エルピーダメモリ株式会社の会社更生法申請に伴い破産更生債権等に対し計上した貸倒引当金2,701百万円などにより資金が増加しましたが、一方で、税金等調整前当期純損失の計上4,723百万円、法人税等の支払1,256百万円により資金が減少したことによるものです。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動によるキャッシュ・フローは、10,671百万円の純支出（前年同期比25.5%の支出増）となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出10,629百万円によるものです。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動によるキャッシュ・フローは、804百万円の純支出（前年同期は2,532百万円の純収入）となりました。これは主に、リース債務の返済による支出6,699百万円と、セール・アンド・リースバック取引による収入5,895百万円によるものです。

(5) 資本の財源及び資金の流動性についての分析

当社グループは、半導体のテスト受託を主な事業としており、この事業は受託量の増加や受託対象製品の増加に際して、使用する測定装置等の投資が先行し、数年にわたって回収していく構造となっております。従って、所要資金の調達については、割賦等の長期安定的な調達方法を取ることに留意しております。この結果、キャッシュ・フローに関し、営業活動によるキャッシュ・フローにおいては減価償却費が、財務活動によるキャッシュ・フローにおいてはリース債務等の長期有利子負債の返済による支出が、それぞれ主な構成要素となっております。また、営業活動によるキャッシュ・フローについては損益の状況が、投資活動によるキャッシュ・フローについては新規設備投資の増減が、それぞれ主な変動要因となっております。

従いまして、手許流動性、すなわち、現金及び現金同等物の水準については、業績の変動に対応するため、連結売上高の3ヶ月分以上の確保が望ましいと考えております。当連結会計年度末においては、現金及び現金同等物の残高は5,557百万円であり、当連結会計年度売上高の約2.8ヶ月分相当を確保しております。

(6) 経営成績に重要な影響を与える要因について

当社グループの売上は、特定顧客への依存度が高いため、当該顧客の生産動向が当社業績に大きな影響を与えます。例えば、当社グループの主力受託品であるDRAMは、主にPCやサーバなどに使用される汎用性の高い(PC用)製品と、携帯電話、デジタル家電などに使用されるカスタム性の高い製品(プレミアムDRAM)に分かれ、テスト負荷の高いプレミアムDRAMの生産量の増減が当社業績に影響を与えます。

特に、当社グループの主要顧客であるエルピーダメモリ株式会社が会社更生法による事業の再建を目指す過程で、生産数量や生産品種の見直しを行うことにより、当社グループが受託する製品が増減する可能性があり、当該再建計画の内容が当社業績に影響を与えます。

当社グループといたしましては、特定の顧客に依存することなくより多くの顧客から、様々な種類の製品を受託するべく、営業活動を強化しております。

特に、現時点ではDRAMの受託比率が高いため、DRAM以外の半導体製品の受託を獲得すべく、新規顧客を含め、様々な半導体製品の受託に向けて営業活動を進めてまいります。

(7) 経営者の問題認識と今後の方針について

当社グループの経営陣は、現在の事業環境及び入手可能な情報に基づき最善の経営方針を立案するよう努めておりますが、ここ数年の半導体業界、特にDRAM市場は需要に比べ供給能力に余裕があるため、経営環境の厳しい時期がありました。特に、世界的な半導体生産拠点である台湾においては、一時DRAM生産を主力としている半導体企業の経営が悪化するなど、今後の動向は予測がつきにくい状況となっております。さらに、当社グループの主要顧客であるエルピーダメモリ株式会社が会社更生法による事業の再建を目指すことになったことで、当社の主力受託品であるDRAMのテスト受託に不透明感がある現時点では、様々な可能性を考慮し、対応策を検討しております。このような状況に対し、平成22年12月の東京証券取引所マザーズ市場上場に伴う公募増資において調達した資金の使途について、予定していたシステムLSI事業への投資に充てるほか、今後の当社グループの業績推移等に柔軟に対応するため、運転資金などにも充当することといたします。

当社グループは、今後も継続して新規顧客の開拓、新規製品の受託を推し進めてまいります。

(8) 重要事象等について

「4 事業等のリスク」に記載のとおり、当社グループの主要な取引先であるエルピーダメモリ株式会社においては、再建に向けた更生手続が開始されたものの、更生計画の認可までには至っていないという状況にあるため、当社には、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在しており、現時点では継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められます。

当社グループでは、特定の取引先に売上高が偏っている状況を変え、より強固な財務体質を築くために、以下のような施策を実行してまいります。

なお、エルピーダメモリ株式会社の更生計画が認可され、当社へのウエハテスト業務委託が継続される場合には、このような不確実性は解消すると考えております。

① システムLSI事業の収益改善

今後は、製品ごとの収益性をより精査し、採算性の低い製品については受託の可否を検討し、低稼働の設備についてはそのあり方を見直してまいります。また、新しい製品の受託にあたっては投資リスクを今まで以上に精査し、顧客とのWin-Winを実現できる関係の確立を目指します。さらに、連結子会社である株式会社テラミクロスが行うWLP(ウエハレベルパッケージ)の省スペース性を武器に、成長しているスマートフォンなどのモバイル製品に搭載される半導体のウエハテストとWLPの受託に注力し、テストとWLPを一貫させたターンキーソリューションの提供による事業拡大を目指してまいります。

コスト削減については、すでに役員報酬の削減を実施しておりますが、これに加えて管理職の賞与削減、外部委託の見直し等により一層のコスト削減を徹底してまいります。

② 資金調達の見直し、実施

当社グループでは、財務基盤の安定化のために、様々な資金調達策を検討し、実施していきます。また、保有設備の選別を進め、低稼働資産の売却を促進していきます。

### 第3【設備の状況】

#### 1【設備投資等の概要】

当連結会計年度の設備投資については、テスト受託能力増強及び新規テスト受託に伴うテスト装置導入のために設備投資を実施し、当連結会計年度の設備投資の総額は7,838,476千円となりました。

また、当連結会計年度から株式会社テラミクロスが新たに連結子会社に加わったことにより、同社の本社工場が当社グループの主要な設備となりました。

なお、セグメントごとの設備投資について示すと、次のとおりであります。

##### (1) メモリ事業

メモリ事業の設備投資額は、5,992,857千円であります。これらは主に、顧客の生産品がテスト負荷の高い製品にシフトし、当社の受託するテストの負荷が増加したことに対応するための設備の取得であります。

##### (2) システムLSI事業

システムLSI事業の設備投資額は、1,744,016千円であります。これらは主に、新たに受託したテスト業務のための設備の取得であります。

当連結会計年度において、稼働の低下した生産設備の売却を行っており、売却額はメモリ事業において645,054千円、システムLSI事業において135,550千円であります。なお、重要な設備の除却はありません。

#### 2【主要な設備の状況】

当社グループにおける主要な設備は、次のとおりであります。

##### (1) 提出会社

平成24年3月31日現在

事業所名 (所在地)	セグメント の名称	設備の内容	帳簿価額					従業員数 (人)
			建物 (千円)	機械及び 装置 (千円)	土地 (千円) (面積㎡)	その他 (千円)	合計 (千円)	
本社・開発センター (神奈川県横浜市港北区)	全事業	本社・ 事務所	23,624	—	—	18,678	42,303	55 (3)
開発センター分室 (神奈川県相模原市中央区)	メモリ 事業	半導体 検査設備他	4,431	—	—	1,212	5,644	—
広島事業所 (広島県東広島市)	メモリ 事業	半導体 検査設備他	320,581	18,993,698	—	1,740,544	21,054,824	165 (51)
九州事業所 (熊本県葦北郡芦北町)	システム LSI事業	半導体 検査設備他	672,511	1,131,388	64,948 (58,660)	123,967	1,992,816	74 (69)

- (注) 1. 帳簿価額のうち「その他」は、構築物、工具、器具及び備品、建設仮勘定の合計であります。なお上記金額には消費税等を含めておりません。
2. 帳簿価額は「固定資産の減損に係る会計基準」及び「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」の適用後の金額を表示しております。
3. 本社・開発センター、開発センター分室及び広島事業所は土地及び建物を賃借しており、年間の賃借料は364,504千円であります。
4. 従業員数の( )は、当連結会計年度末までの1年間の臨時雇用者数の平均を外書しております。
5. 開発センター分室は常駐者はありません。
6. リース契約による主な賃借設備は、以下のとおりであります。

事業所名(所在地)	設備の内容	数量	リース期間 (年)	年間リース料 (千円)	リース契約残高 (千円)
広島事業所 (広島県東広島市)	半導体検査設備 (ファイナンス・リース)	一式	2～5	5,483,192	9,394,480
九州事業所 (熊本県葦北郡芦北町)	半導体検査設備 (ファイナンス・リース)	一式	5～8	939,670	1,120,359

## (2) 国内子会社

平成24年3月31日現在

会社名	事業所名 (所在地)	セグメント の名称	設備の内容	帳簿価額					従業員数 (人)
				建物 (千円)	機械及び 装置 (千円)	土地 (千円) (面積㎡)	その他 (千円)	合計 (千円)	
(株)テラミクロス	本社・工場 (東京都青梅市)	システム LSI事業	半導体 組立設備他	406,570	831,926	473,000 (7,286)	59,469	1,770,967	263 (37)

- (注) 1. 帳簿価額のうち「その他」は、構築物、車両運搬具、工具、器具及び備品、建設仮勘定の合計であります。なお上記金額には消費税等を含めておりません。
2. 従業員数の( )は、当連結会計年度末までの1年間の臨時雇用者数の平均を外書しております。
3. リース契約による主な賃借設備は、以下のとおりであります。

事業所名(所在地)	設備の内容	数量	リース期間 (月)	年間リース料 (千円)	リース契約残高 (千円)
本社・工場 (東京都青梅市)	半導体組立設備 (ファイナンス・リース)	一式	18~72	408,351	708,899

## (3) 在外子会社

平成24年3月31日現在

会社名	事業所名 (所在地)	セグメント の名称	設備の内容	帳簿価額					従業員数 (人)
				建物 (千円)	機械及び 装置 (千円)	土地 (千円) (面積㎡)	その他 (千円)	合計 (千円)	
TeraPower Technology Inc.	本社・工場 (台湾新竹縣)	メモリ事業	半導体 検査設備他	1,526,615	1,947,677	361,715 (6,135)	121,075	3,957,084	103

- (注) 帳簿価額のうち「その他」は、車両運搬具、工具、器具及び備品、建設仮勘定の合計であります。なお上記金額には消費税等を含めておりません。

## 3 【設備の新設、除却等の計画】

当連結会計年度末現在における重要な設備の新設、除却等の計画はありません。

## 第4【提出会社の状況】

### 1【株式等の状況】

#### (1)【株式の総数等】

##### ①【株式の総数】

種類	発行可能株式総数(株)
普通株式	30,000,000
計	30,000,000

##### ②【発行済株式】

種類	事業年度末現在 発行数(株) (平成24年3月31日)	提出日現在発行数 (株) (平成24年6月26日)	上場金融商品取 引所名又は登録 認可金融商品取 引業協会名	内容
普通株式	9,282,500	9,282,500	東京証券取引所 (マザーズ)	完全議決権株式であり、権利内容 に何ら制限の無い当社の標準とな る株式で、単元株式数は100株で あります。
計	9,282,500	9,282,500	—	—

(注) 「提出日現在発行数」欄には、平成24年6月1日から本書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。

(2) 【新株予約権等の状況】

会社法に基づき発行した新株予約権は次のとおりであります。

平成20年2月15日臨時株主総会決議

区分	事業年度末現在 (平成24年3月31日)	提出日の前月末現在 (平成24年5月31日)
新株予約権の数(個)	4,382 (注)1	4,373 (注)1
新株予約権のうち 自己新株予約権の数(個)	—	—
新株予約権の目的となる 株式の種類	普通株式	同左
新株予約権の目的となる 株式の数(株)	438,200 (注)1,2,3	437,300 (注)1,2,3
新株予約権の行使時の 払込金額(円)	1株当たり 2,650(注)3,4	1株当たり 2,650(注)3,4
新株予約権の行使期間	自 平成22年3月1日 至 平成27年3月31日	同左
新株予約権の行使により株式 を発行する場合の株式の発行 価格及び資本組入額(円)	発行価格 2,650 資本組入額 1,325 (注)3	発行価格 2,650 資本組入額 1,325 (注)3
新株予約権の行使の条件	(1)新株予約権の割当を受けた者は、割当日から権利行使に至るまでの間、当社又は当社がその総株主の議決権の過半数を直接又は間接に保有している会社の従業員、執行役員、取締役もしくは監査役の地位にあることを要す。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由のある場合はこの限りではない。 (2)新株予約権の相続による継承は、新株予約権の割当を受けた者が被相続人となる相続においてのみ、これを認める。当該相続後の相続における相続人は、新株予約権を継承することが出来ない。 (3)割当日から権利行使に至るまでの間、新株予約権の質入れその他の担保権を設定した場合は、行使を認めない。 (4)その他の条件については、当社株主総会決議及び当社取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受ける者との間で締結する「株式会社テラプローブ新株予約権付与契約書」に定めるところによる。	同左
新株予約権の譲渡に関する 事項	譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要する。	同左
代用払込みに関する事項	—	—
組織再編成行為に伴う新株 予約権の交付に関する事項	—	—

(注)1. 新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、臨時株主総会決議における新株予約権の数及び新株発行予定数から、退職により権利を喪失した者の新株予約権の数及びその目的となる株式の数を減じております。

2. 本新株予約権1個当たりの新株予約権の目的となる株式数(以下、「付与株式数」といいます。)は、新株予約権付与時には10株とします。なお、当社が普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数(以下、「未発行付与株式数」といいます。)について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。

調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割又は株式併合の比率

当社は、平成22年5月11日開催の取締役会の決議に基づき、平成22年5月27日を基準日として平成22年5月28日付で当社普通株式1株につき10株の株式分割を行っているため、提出日現在、新株予約権1個当たりの新株予約権の目的となる株式数は100株となっております。

また、新株予約権発行後、当社が他社と吸収合併をし、当社が吸収合併存続会社となる場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、又は当社が吸収分割承継会社となる吸収分割を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときには、当社は、合理的な範囲で必要と認める未発行付与株式数の調整を行うことができます。

新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとします。

3. 平成22年5月11日開催の取締役会の決議に基づき、平成22年5月27日を基準日として平成22年5月28日付で当社普通株式1株につき10株の株式分割を行っており、上記の表に記載の「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」は、調整後の数で記載しております。
4. 当社が当社普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げます。

$$\text{調整後払込金額} = \text{調整前払込金額} \times \frac{1}{\text{分割・併合の割合}}$$

また、時価を下回る価額で新株を発行する場合又は自己株式を処分する場合(新株予約権の行使によるものを除く)は、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げます。

$$\text{調整後払込金額} = \text{調整前払込金額} \times \frac{\text{既発行株式数} + \frac{\text{新規発行株式数} \times 1 \text{株当たりの払込金額}}{\text{新規発行前の株価}}}{\text{既発行株式数} + \text{新規発行による増加株式数}}$$

上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式数から当社が保有する普通株式にかかる自己株式を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たりの払込金額」を「1株当たりの処分金額」と読み替えるものとします。

また、新株予約権発行後、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、又は当社が吸収分割承継会社となる吸収分割を行う場合等、払込金額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときには、当社は、合理的な範囲で払込金額の調整を行うことができます。

5. 当社グループ監査役のうち、エルピーダグループにおいて監査役を兼務する者は、新株予約権の権利行使時において、当社グループの従業員、執行役員、取締役もしくは監査役のいずれの地位にもなく、かつ、エルピーダグループのそれらの地位のいずれかにある状態においては、新株予約権を行使する権利が停止されることについて平成22年10月27日に締結した覚書に基づき合意しております。



区分	事業年度末現在 (平成24年3月31日)	提出日の前月末現在 (平成24年5月31日)
新株予約権の数(個)	479(注)1	479(注)1
新株予約権のうち 自己新株予約権の数(個)	—	—
新株予約権の目的となる 株式の種類	普通株式	同左
新株予約権の目的となる 株式の数(株)	47,900 (注)1,2,3	47,900 (注)1,2,3
新株予約権の行使時の 払込金額(円)	1株当たり 2,650(注)3,4	1株当たり 2,650(注)3,4
新株予約権の行使期間	自 平成24年4月1日 至 平成29年3月31日	同左
新株予約権の行使により株式 を発行する場合の株式の発行 価格及び資本組入額(円)	発行価格 2,650 資本組入額 1,325 (注)3	発行価格 2,650 資本組入額 1,325 (注)3
新株予約権の行使の条件	(1)新株予約権の割当を受けた者は、割当日から権利行使に至るまでの間、当社又は当社がその総株主の議決権の過半数を直接又は間接に保有している会社の従業員、執行役員、取締役もしくは監査役の地位にあることを要す。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由のある場合はこの限りではない。 (2)新株予約権の相続による継承は、新株予約権の割当を受けた者が被相続人となる相続においてのみ、これを認める。当該相続後の相続における相続人は、新株予約権を継承することが出来ない。 (3)割当日から権利行使に至るまでの間、新株予約権の質入れその他の担保権を設定した場合は、行使を認めない。 (4)その他の条件については、当社株主総会決議及び当社取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受ける者との間で締結する「株式会社テラプローブ新株予約権付与契約書」に定めるところによる。	同左
新株予約権の譲渡に関する 事項	譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要する。	同左
代用払込みに関する事項	—	—
組織再編成行為に伴う新株 予約権の交付に関する事項	—	—

(注)1. 新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、臨時株主総会決議における新株予約権の数及び新株発行予定数から、退職により権利を喪失した者の新株予約権の数及びその目的となる株式の数を減じております。

2. 本新株予約権1個当たりの新株予約権の目的となる株式数(以下、「付与株式数」といいます。)は、新株予約権付与時には10株とします。なお、当社が普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数(以下、「未発行付与株式数」といいます。)について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。

調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割又は株式併合の比率

当社は、平成22年5月11日開催の取締役会の決議に基づき、平成22年5月27日を基準日として平成22年5月28日付で当社普通株式1株につき10株の株式分割を行っているため、新株予約権1個当たりの新株予約権の目的となる株式数は100株となっております。

また、新株予約権発行後、当社が他社と吸収合併をし、当社が吸収合併存続会社となる場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、又は当社が吸収分割承継会社となる吸収分割を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときには、当社は、合理的な範囲で必要と認める未発行付与株式数の調整を行うことができます。

新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとします。

3. 平成22年5月11日開催の取締役会の決議に基づき、平成22年5月27日を基準日として平成22年5月28日付で当社普通株式1株につき10株の株式分割を行っており、上記の表に記載の「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」は、調整後の数で記載しております。
4. 当社が当社普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げます。

$$\text{調整後払込金額} = \text{調整前払込金額} \times \frac{1}{\text{分割・併合の割合}}$$

また、時価を下回る価額で新株を発行する場合又は自己株式を処分する場合(新株予約権の行使によるものを除く)は、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げます。

$$\text{調整後払込金額} = \text{調整前払込金額} \times \frac{\text{既発行株式数} + \frac{\text{新規発行株式数} \times 1 \text{株当たりの払込金額}}{\text{新規発行前の株価}}}{\text{既発行株式数} + \text{新規発行による増加株式数}}$$

上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式数から当社が保有する普通株式にかかる自己株式を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たりの払込金額」を「1株当たりの処分金額」と読み替えるものとします。

また、新株予約権発行後、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、又は当社が吸収分割承継会社となる吸収分割を行う場合等、払込金額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときには、当社は、合理的な範囲で払込金額の調整を行うことができます。

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

(4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日	発行済普通株式総数増減数(株)	発行済普通株式総数残高(株)	発行済A種類株式総数増減数(株)	発行済A種類株式総数残高(株)	資本金増減額(千円)	資本金残高(千円)	資本準備金増減額(千円)	資本準備金残高(千円)
平成20年 2月15日(注1)	130,000	260,000	254,000	508,000	—	9,600,000	—	9,156,955
平成21年 3月1日(注2)	112,000	372,000	—	508,000	—	9,600,000	—	9,156,955
平成21年 3月24日(注2)	368,000	740,000	—	508,000	—	9,600,000	—	9,156,955
平成22年 3月11日(注2)	28,000	768,000	—	508,000	—	9,600,000	—	9,156,955
平成22年 3月31日(注3)	—	768,000	△508,000	—	—	9,600,000	—	9,156,955
平成22年 5月28日(注4)	6,912,000	7,680,000	—	—	—	9,600,000	—	9,156,955
平成22年 12月15日(注5)	1,600,000	9,280,000	—	—	2,220,000	11,820,000	2,220,000	11,376,955
平成22年 4月1日～ 平成23年 3月31日(注6)	2,500	9,282,500	—	—	3,313	11,823,313	3,313	11,380,267

- (注) 1. 平成20年1月22日開催の取締役会の決議に基づき、平成20年2月14日を基準日として平成20年2月15日に当社普通株式及びA種類株式1株を2株とする株式分割を実施し、発行済株式総数が384,000株増加しております。
2. 株主からの請求により、当社A種類株式1株につき当社普通株式1株を交付したことにより発行済株式総数が増加しております。
3. 平成22年3月24日開催の取締役会の決議に基づき、平成22年3月31日に自己株式508,000株(A種類株式)を消却しております。
4. 平成22年5月11日開催の取締役会の決議に基づき、平成22年5月27日を基準日として平成22年5月28日付で当社普通株式1株につき10株の株式分割を実施し、発行済株式総数が6,912,000株増加し、7,680,000株となっております。
5. 有償一般募集(ブックビルディング方式による募集)  
発行価格 3,000円 引受価額 2,775円  
資本組入額 1,387.50円 払込金総額 4,440,000千円
6. 新株予約権の行使による増加であります。
7. 平成22年11月11日提出の有価証券届出書、平成22年11月29日提出の有価証券届出書の訂正届出書及び平成22年12月7日提出の有価証券届出書の訂正届出書第一部、第1、5(2)「手取金の使途」において、手取概算額4,413,000千円については、第三者割当増資の手取上限額1,332,000千円と合わせた手取概算額合計上限5,745,000千円全額をシステムLSI事業のテスト受託能力の強化を目的とした半導体検査設備等の投資資金として平成23年3月期及び平成24年3月期に充当する予定であるとしておりましたが、特に、世界的な半導体生産拠点である台湾においては、一時DRAM生産を主力としている半導体企業の経営が悪化するなど、今後の動向は予測が付きにくい状況となっていること、さらに、当社グループの主要顧客であるエルピーダメモリ株式会社が会社更生法による事業の再建を目指すことになったことで、当社の主力受託品であるDRAMのテスト受託に不透明感があることを考慮し、平成25年3月期以降、予定していたシステムLSI事業への投資に充てるほか、今後の当社グループの業績推移等に柔軟に対応するため、運転資金などにも充当することといたします。

## (6) 【所有者別状況】

平成24年3月31日現在

区分	株式の状況（1単元の株式数100株）								単元未満株式の状況（株）
	政府及び地方公共団体	金融機関	金融商品取引業者	その他の法人	外国法人等		個人その他	計	
					個人以外	個人			
株主数(人)	—	4	25	47	48	1	2,932	3,057	—
所有株式数(単元)	—	407	1,472	44,856	30,084	2	15,994	92,815	1,000
所有株式数の割合(%)	—	0.44	1.59	48.32	32.42	0.00	17.23	100	—

## (7) 【大株主の状況】

平成24年3月31日現在

氏名又は名称	住所	所有株式数(株)	発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%)
エルピーダメモリ株式会社	東京都中央区八重洲2丁目2番1号	3,680,000	39.64
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC (常任代理人 モルガン・スタンレーMUFJ証券株式会社)	25 Cabot Square, Canary Wharf, London E14 4QA, U.K. (東京都渋谷区恵比寿4丁目20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー)	1,129,300	12.17
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL (常任代理人 ゴールドマン・サックス証券株式会社)	133 FLEET STREET LONDON EC4A 2BB, UK (東京都港区六本木6丁目10番1号 六本木ヒルズ森タワー)	770,500	8.30
株式会社アドバンテスト	東京都練馬区旭町1丁目32-1号	760,000	8.19
MLPFS CUSTODY ACCOUNT (常任代理人 メリルリンチ日本証券株式会社)	SOUTH TOWER WORLD FINANCIAL CENTER NEW YORK N.Y. USA (東京都中央区日本橋1丁目4-1 日本橋一丁目ビルディング)	361,700	3.90
CGML-LONDON EQUITY (常任代理人 シティバンク銀行株式会社)	CITIGROUP CENTRE, CANADA SQUARE, CANARY WHARF LONDON E14 5LB (東京都品川区東品川2丁目3番14号)	143,400	1.54
UBS AG London Asia Equities (常任代理人 UBS証券株式会社)	1 Finsbury Avenue, London, EC2M 2PP, United Kingdom (東京都千代田区大手町1丁目5-1 大手町ファーストスクエアイーストタワー)	84,500	0.91
神林 忠弘	新潟県新潟市中央区	68,600	0.74
BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG (FE-AC) (常任代理人 株式会社三菱東京UFJ銀行)	PETERBOROUGH COURT 133 FLEET STREET LONDON EC4A 2BB, UNITED KINGDOM (東京都千代田区丸の内2丁目7-1 決済事業部)	62,400	0.67
DEUTSCHE BANK AG LONDON-PB NON-TREATY CLIENTS 613 (常任代理人 ドイツ証券株式会社)	TAUNUSANLAGE 12, D-60325 FRANKFURT AM MAIN, FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY (東京都千代田区永田町2丁目11番1号 山王パークタワー)	60,600	0.65
計	—	7,121,000	76.71

(注) パワーテックテクノロジー インク (POWERTECH TECHNOLOGY INC.) から、平成22年12月24日付の大量保有報告書の写しの送付があり、平成22年12月16日現在で以下のとおり株式を保有している旨の報告を受けておりますが、当社として当事業年度末現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。

大量保有者	パワーテックテクノロジー インク (POWERTECH TECHNOLOGY INC.)
住所	NO. 26, DATONG RD., HSINCHU INDUSTRIAL HUKOU TOWNSHIP, HSINCHU COUNTY 303, TAIWAN
保有株券等の数	1,040,000株
株券等保有割合	11.21%







































































































































































